



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D204223 S

(45)公告日：中華民國 109 (2020) 年 04 月 21 日

(21)申請案號：108305647

(22)申請日：中華民國 108 (2019) 年 09 月 18 日

(51)LOC.(11)Cl.：13-03

(30)優先權：2019/03/19 日本

2019-005889

(71)申請人：日商日立全球先端科技股份有限公司 (日本) HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION (JP)

日本

(72)設計人：渡部拓 WATANABE, TAKU (JP)

(74)代理人：林志剛

(56)參考文獻：

JP D1255399

JP D1267922

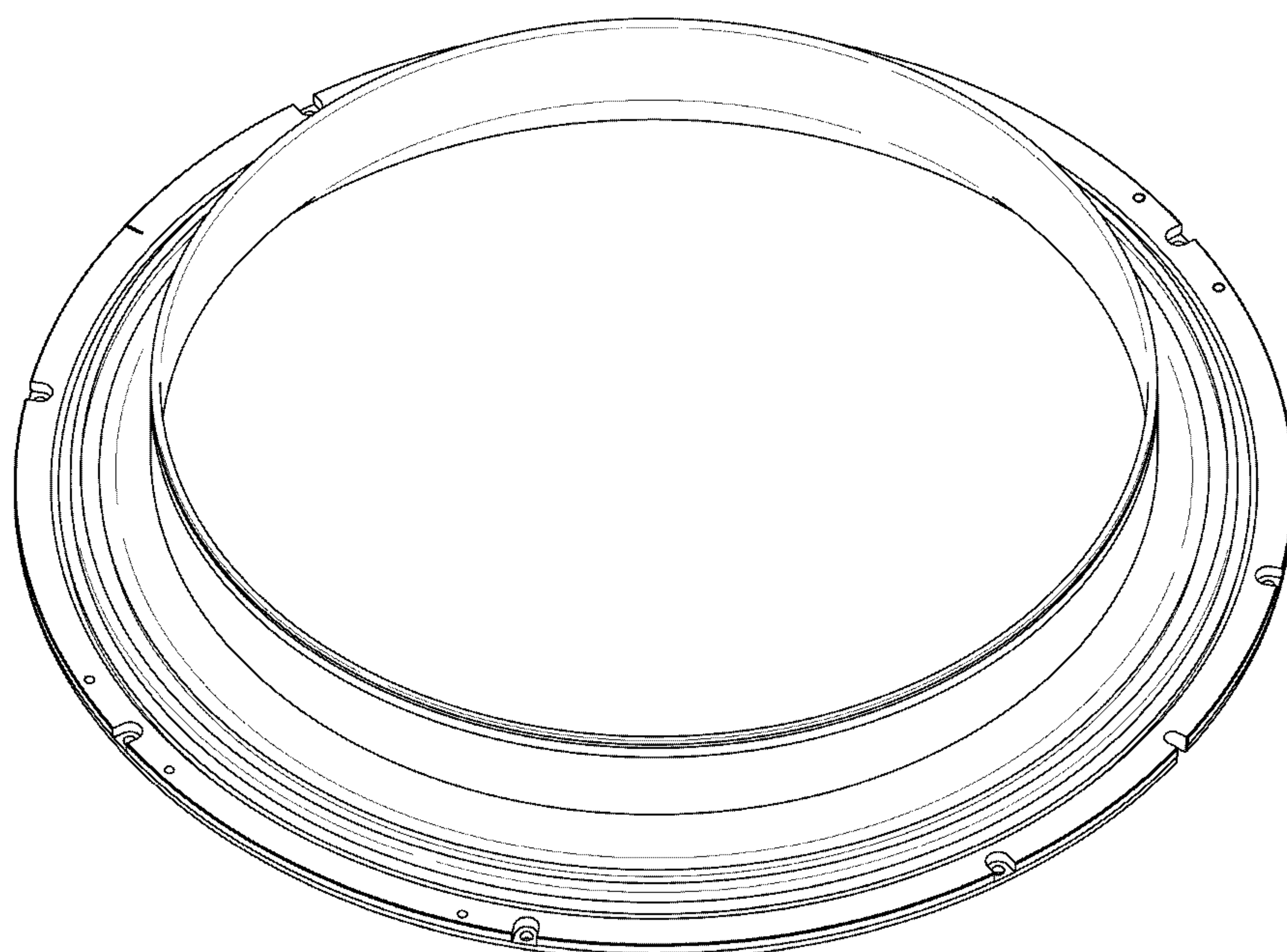
審查人員：葉耀宗

圖式數：11 共 7 頁

(54)名稱

電漿處理裝置用接地電極

代表圖：



【立體圖1】



公告本

D204223

【設計說明書】

【中文設計名稱】電漿處理裝置用接地電極

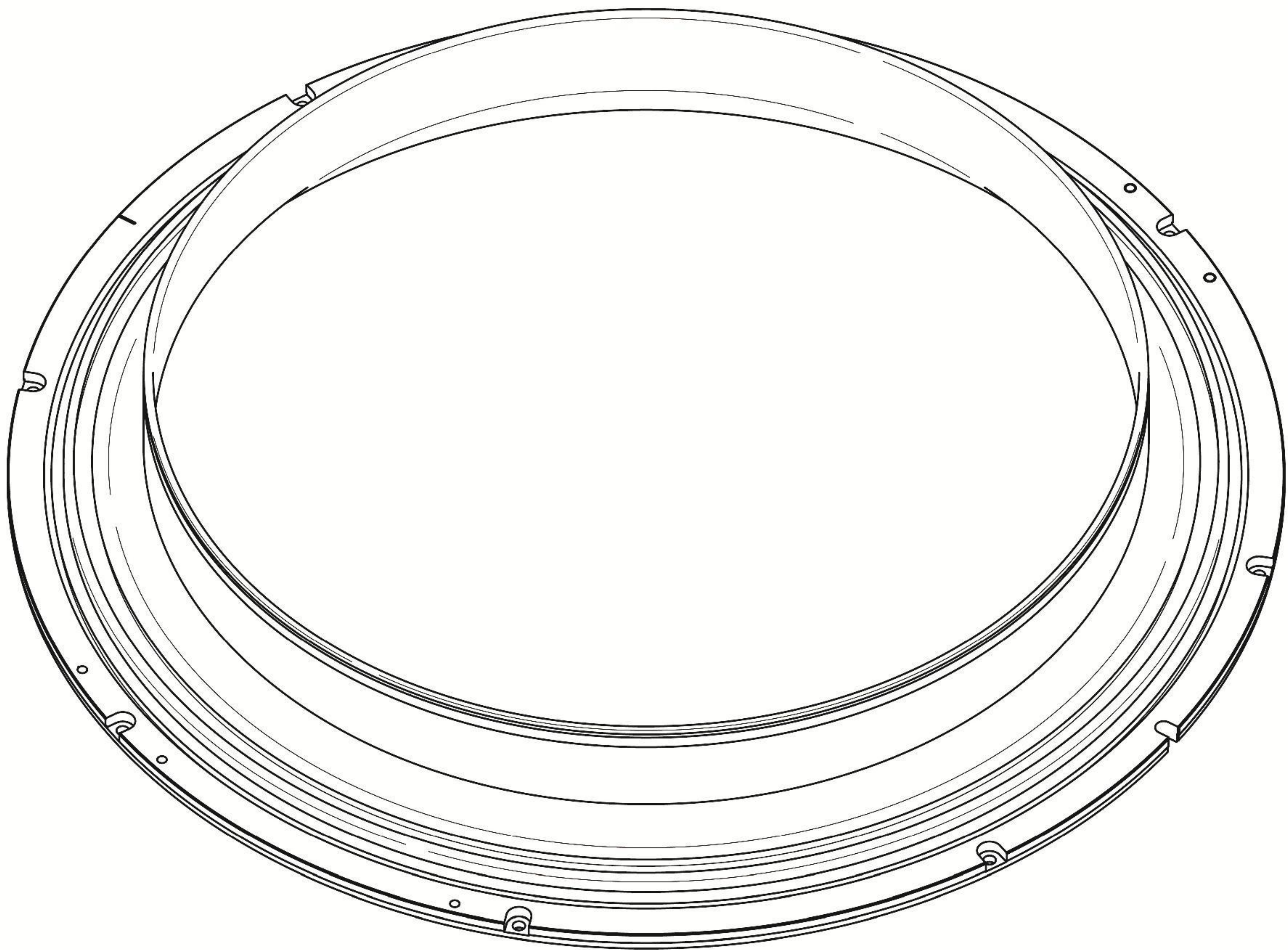
【物品用途】

【0001】本設計的物品是電漿處理裝置用接地電極，為一種應用於在半導體製造裝置中所使用的電漿處理裝置的接地電極。本物品的功能是具有使得照射到放置有即將被加工的半導體晶圓之處理室內的微波及處理室內的氣流更均勻，而可對於半導體晶圓面提供穩定的電漿。

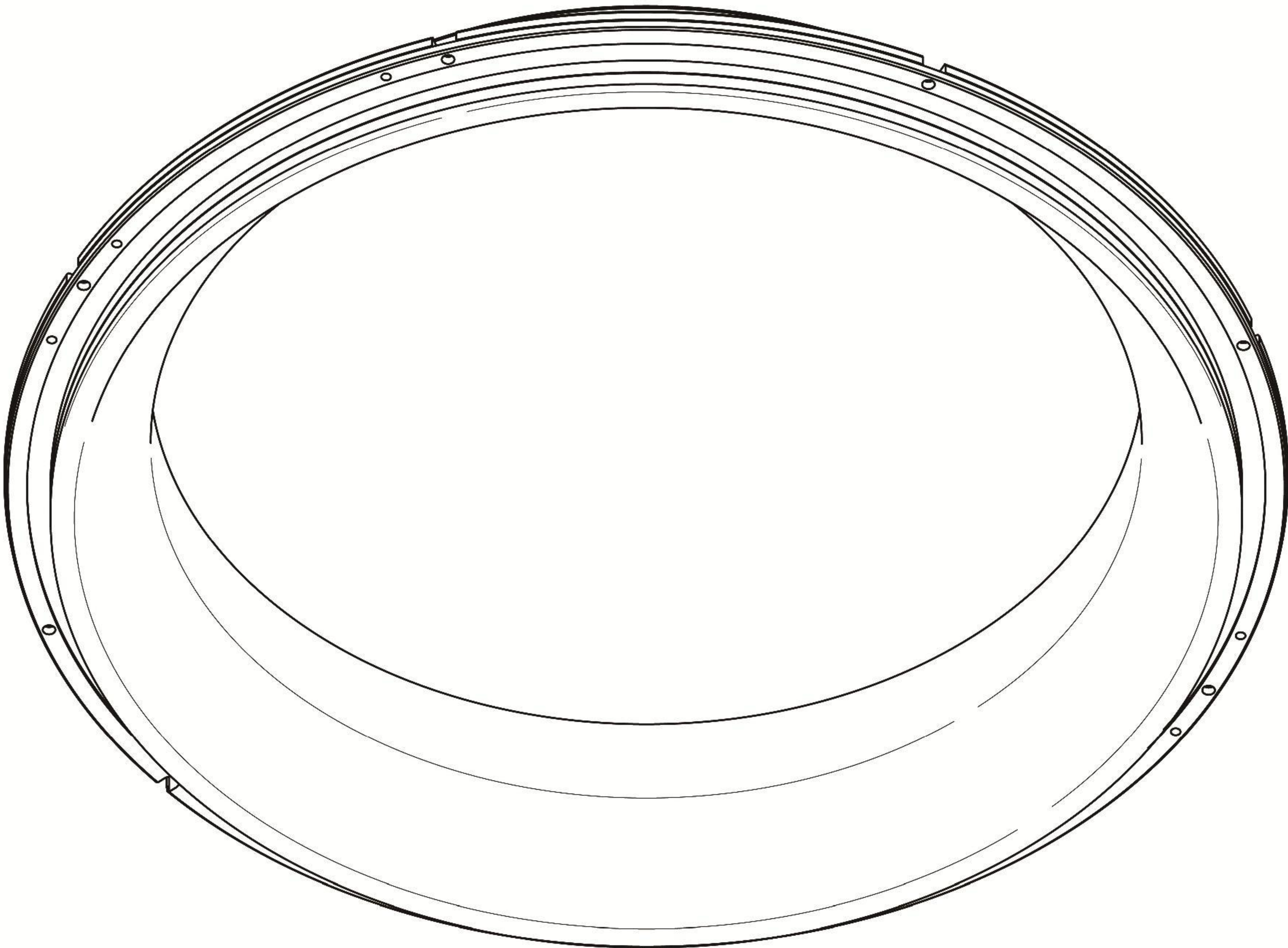
【設計說明】

【0002】各立體圖中，未呈現在六面圖的細線，皆為用來表現立體表面之形狀的線條。

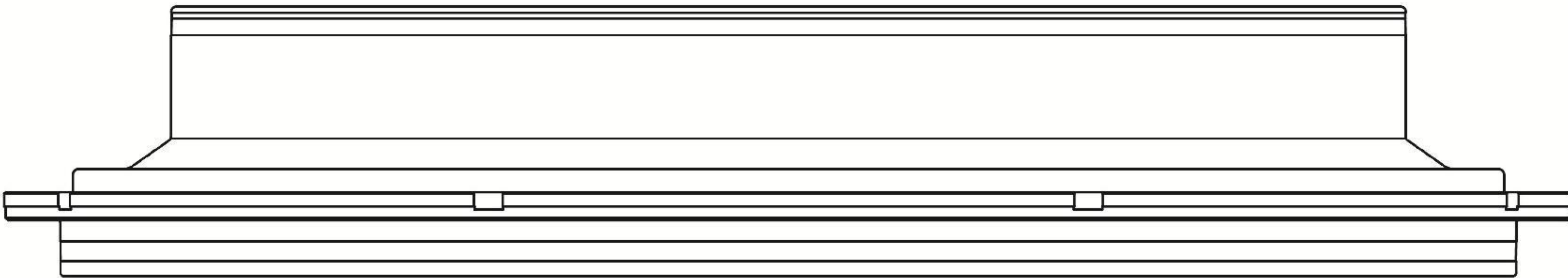
【設計圖式】
(指定代表圖)



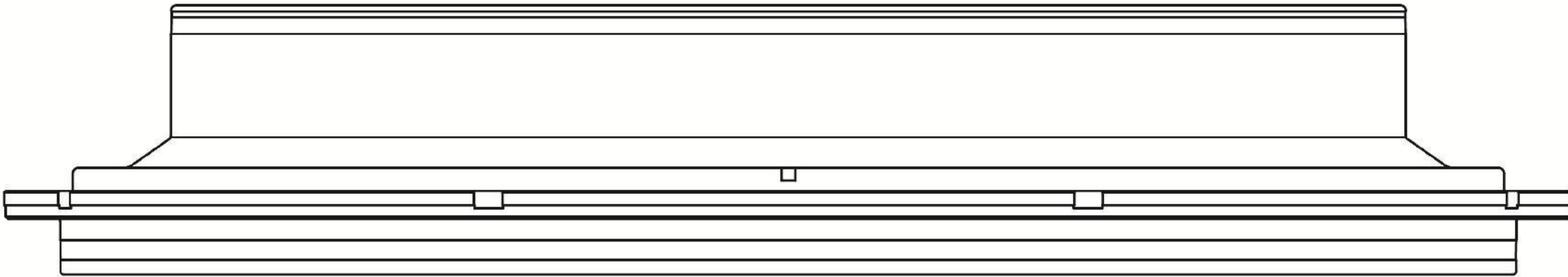
【立體圖 1】



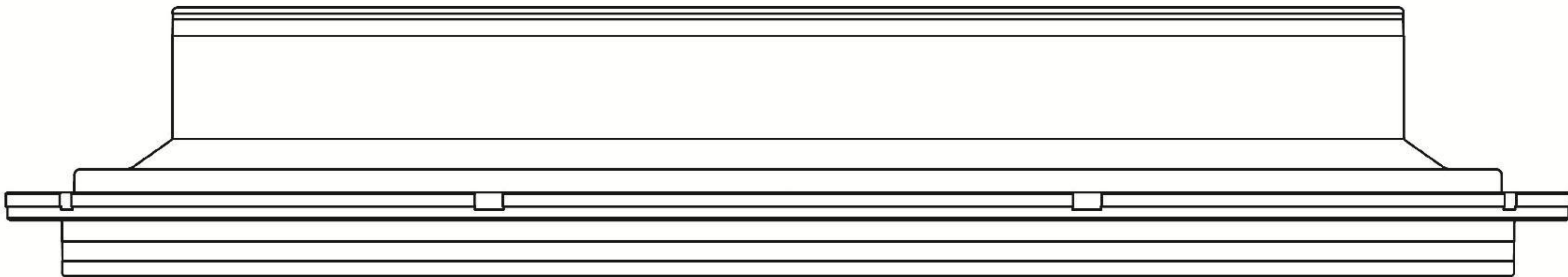
【立體圖 2】



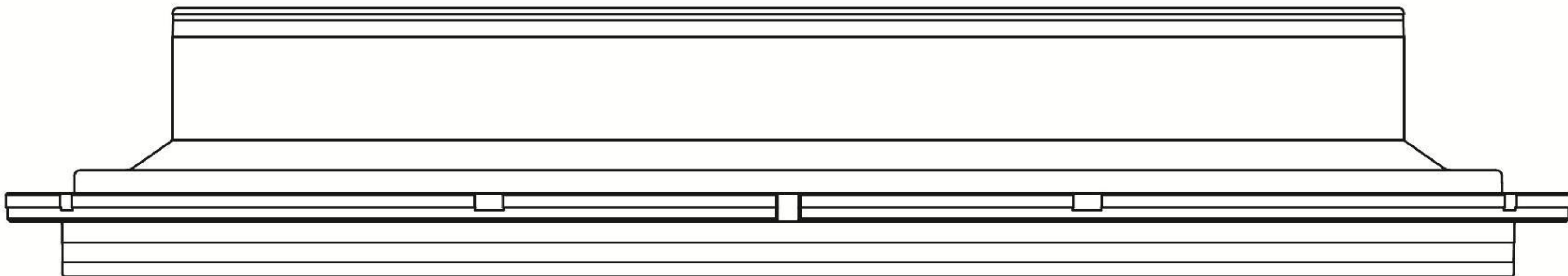
【前視圖】



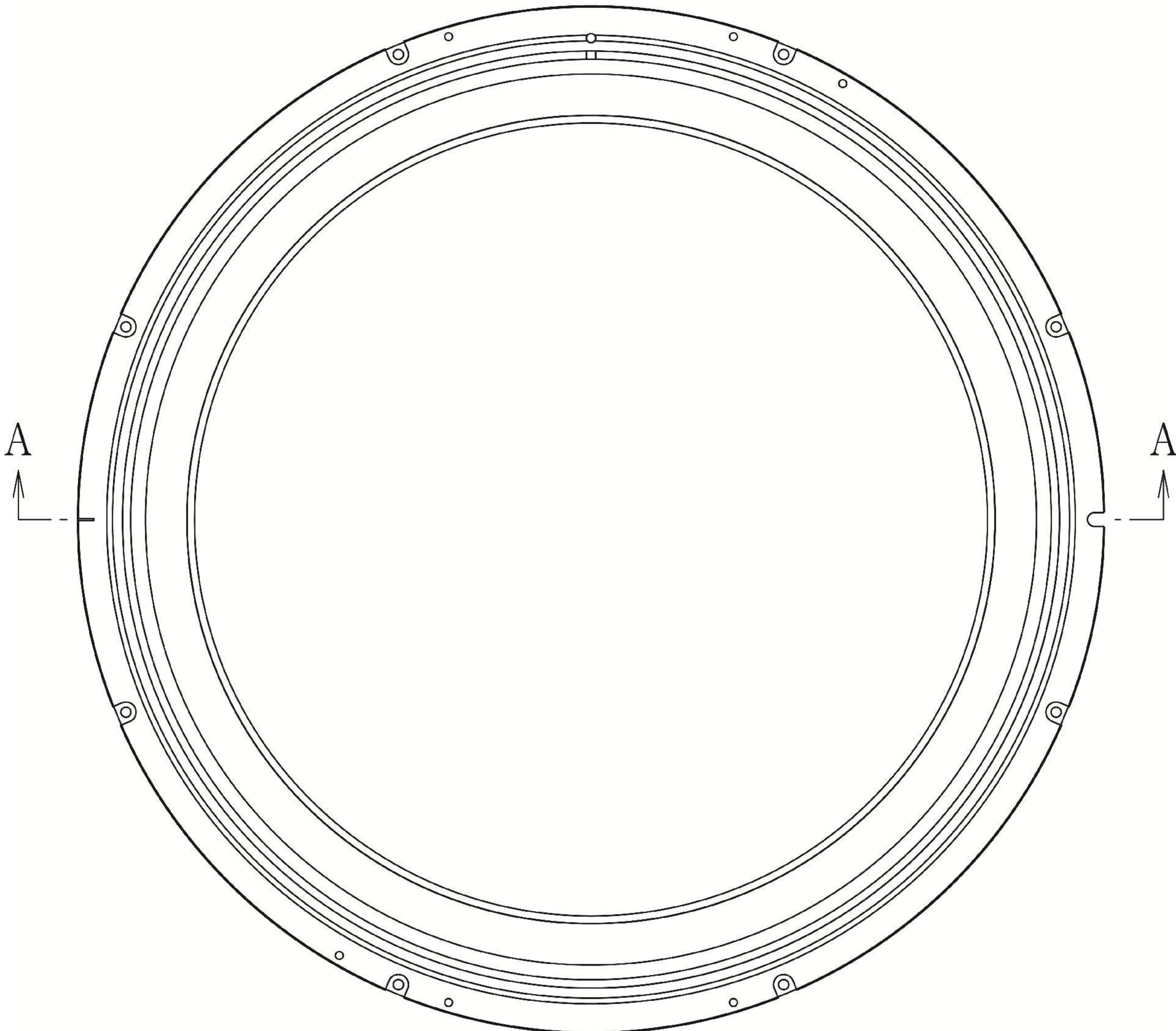
【後視圖】



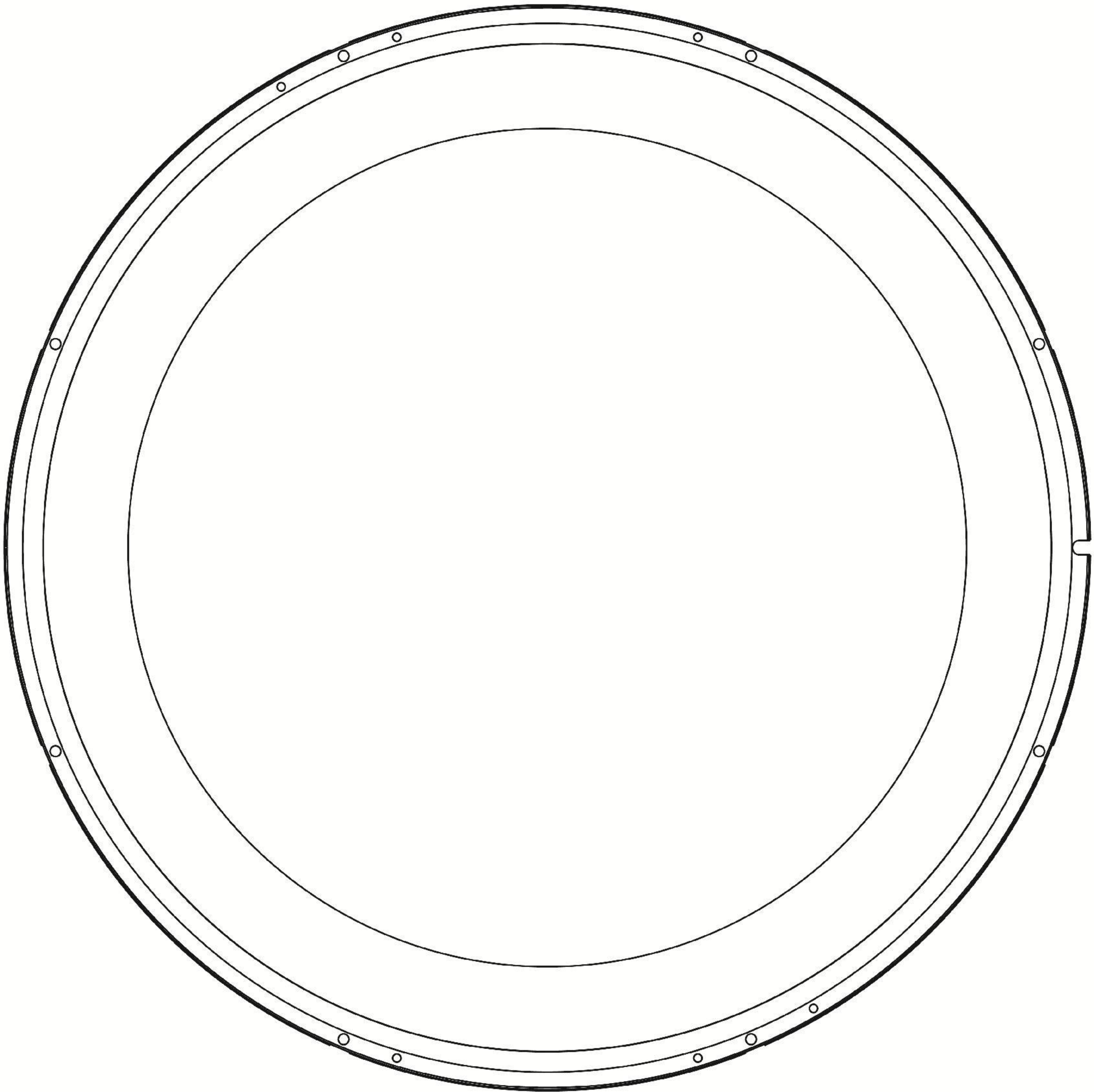
【左側視圖】



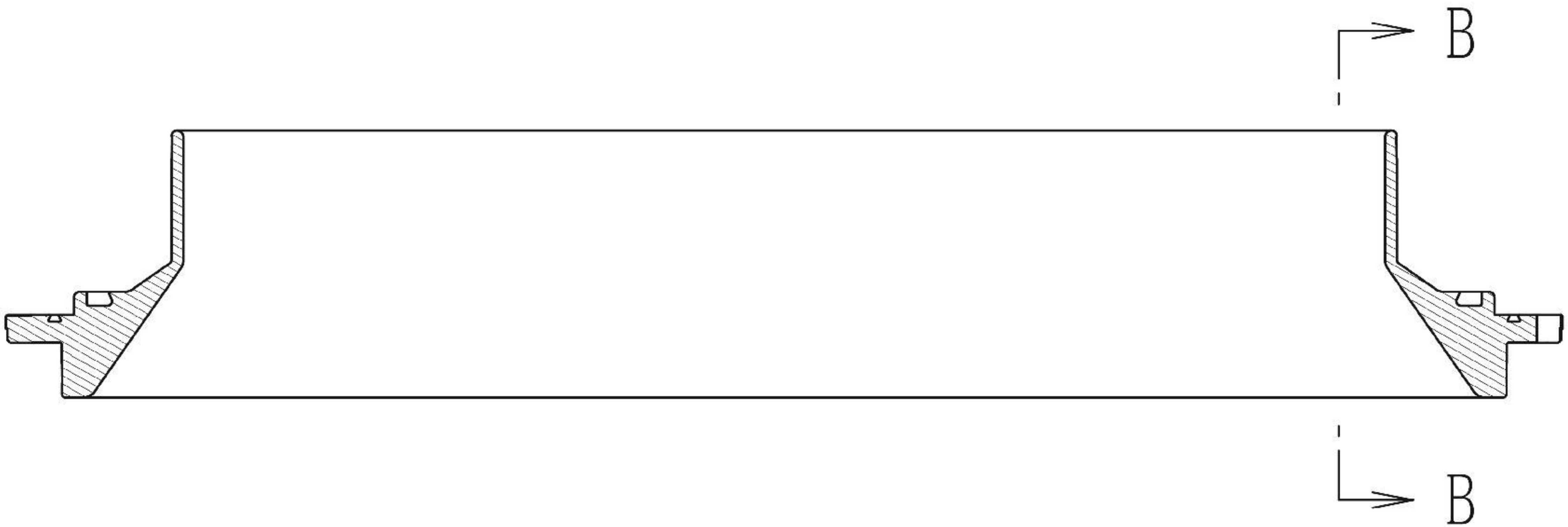
【右側視圖】



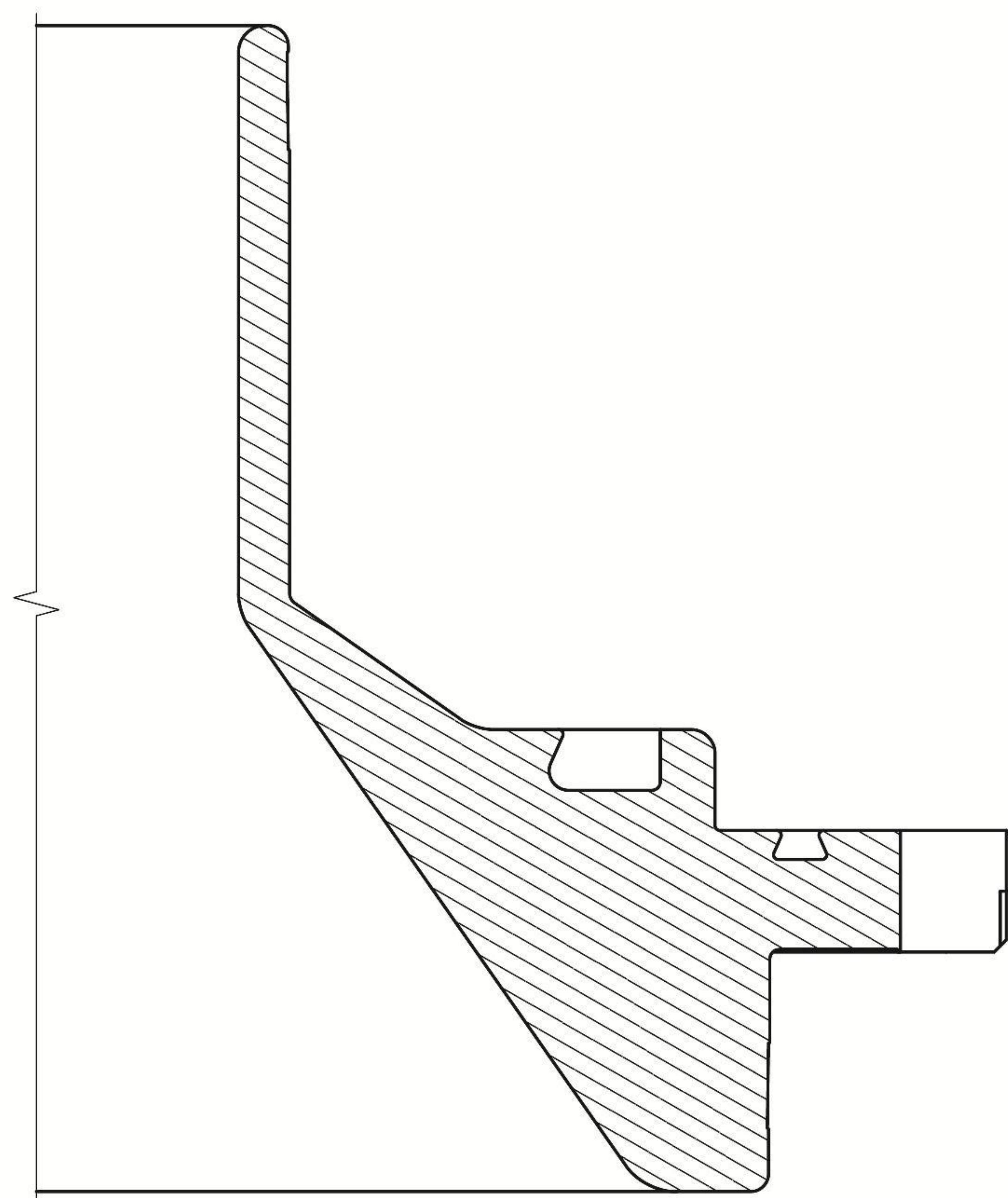
【俯視圖】



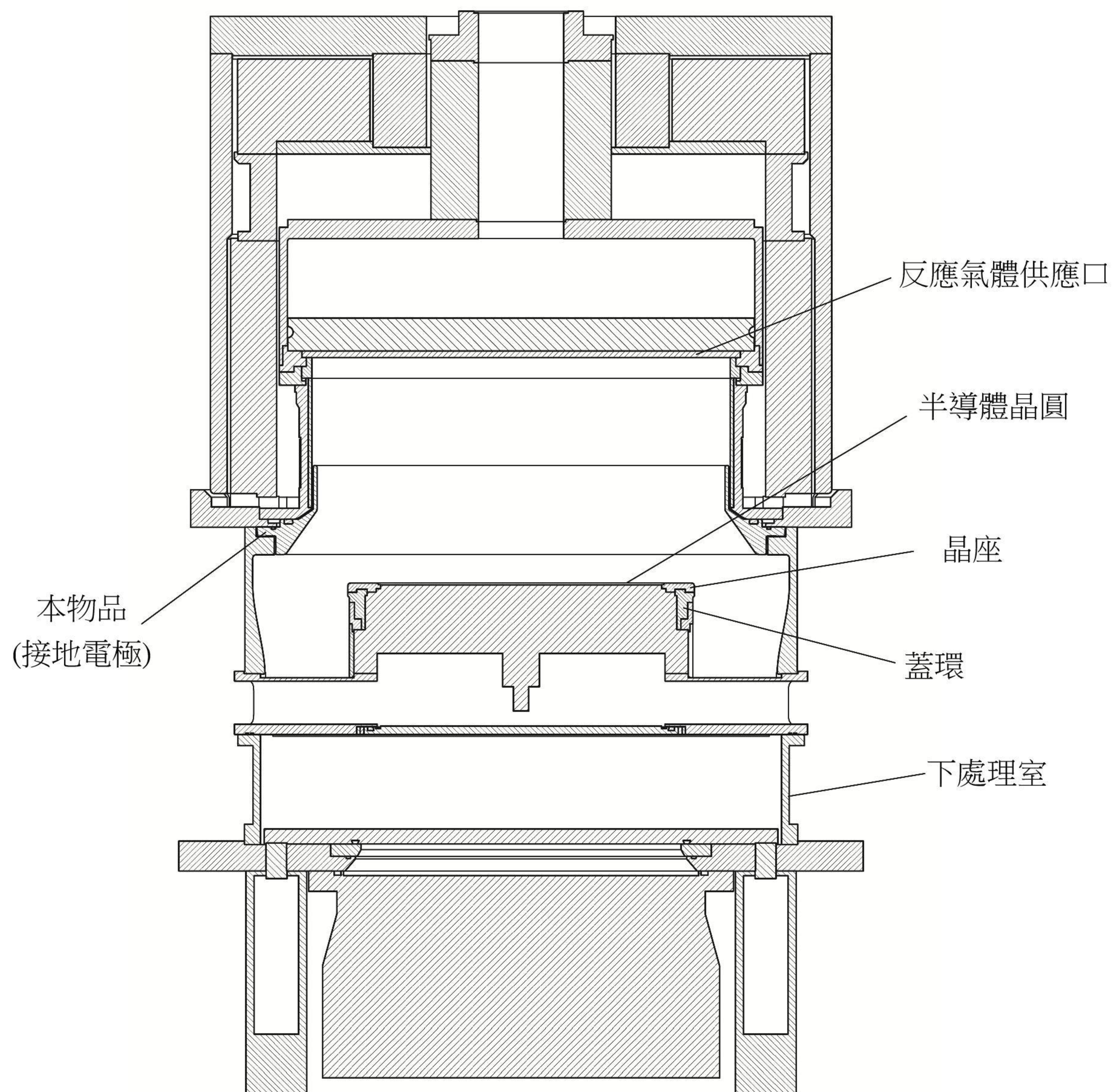
【仰視圖】



【A-A剖面圖】



【B-B部分放大圖】



【使用狀態及標示各部名稱之參考圖】